

2026 NEPCON JAPAN SoBuJang Technology Collaboration Forum

2026. 1. 21 ~ 1. 23 / East Hall E13-8

SoBuJang技術融合フォーラムとは。

現在の製造業は、単なる生産の枠を超え、技術の融合とグローバルな連携が不可欠な時代を迎えました。しかし、一社のみでこれらに対応することは容易ではありません。だからこそ、確かな情報、ネットワーク、そしてビジネスチャンス兼ね備えた「プラットフォーム」が必要とされています。

その答えを提示するのが、韓国発のSoBuJang（ソブジャン）フォーラムです。当フォーラムは、中小企業のビジネス成長とエコシステムの育成を目的に設立された民間団体です。現在、会員数は370名を超え、今もなお拡大を続けています。

私たちは「グローバル製造業のハブ」となることを目標に掲げ、産業の枠を超えたオープンな協力体制を構築し、国内外の製造企業へ新たなビジネス機会を提供してまいります。特に、海外企業の皆様には、韓国企業との強力なパートナーシップをご提案いたします。

1) 最新技術及び市場情報

技術コンサルティング、顧客紹介及び最新産業動向の提供により競争力を強化

2) ネットワーク拡張

国内外の異種産業間の協力、共通マーケティング、定期的なビジネスマッチメイキングを通じた機会創出

3) グローバル進出

海外展示会共同館、国際ビジネスマッチメイキング、海外拠点支援でグローバル市場参入

【主な活動内容】

- 国内外のマッチングプログラム運営（例：韓国～オランダ間など）
- 日本企業とのネットワーク支援（韓国の部品・設備調達に向けた連携支援）

韓国国内のネットワーク、ビジネスチャンス、最新の技術情報を必要とされている方は、ぜひSoBuJangフォーラムまでお問い合わせください。

CONTACT US

Homepage | sobujangforum.com / E-mail | sobujang@starc.co.kr



KEY PARTNERS

TNO / Embassy of the Netherlands in Korea / TNP / 三菱電機オートメーション KOREA / 栄電子

2026 NEPCON JAPAN

SBJ Forum Joint Pavilion



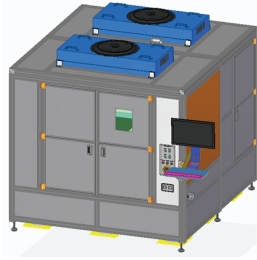
Hardram

#Micro-LED Transfer #AOI Inspection #TGV

顧客に合わせての最新レーザー技術設備

レーザー・光学に最新技術を加えて
ターンキー・ソリューションで
先端設備を製作

Manufacturing advanced
equipment with Turn-key
solution that combines Laser /
Optics with the latest stage
technology



XAVIS

#X-ray #TGV #TSV #WAFER
#ナノ顕微鏡 #二次電池 #半導体
#CT Inspection # Auto Inspection #2D #2.5D #3D #AXI

X-ray Automatic Vision Inspection Solution

Xscan-9860A (250nm Resolution)

- 超高解像度非破壊自動検査装置
- 半導体量産ライン納品実績保有
- 韓国生産技術研究院公認認証製品



TXM-XUI(30nm Resolution)

- 世界初の二重倍率システム
- 物体の内部構造を3Dで高解像度非破壊分析
- 吸収コントラストと技術を使用してナノスケールの3D X線イメージングが可能



イノメトリー (Innometry)

#ガラス基板検査装置(TGV Inspection Machine)
#PKG検査装置(PKG Inspection Machine)
#X線検査装置(X-ray Inspection Machine)
#CT検査装置(CT Inspection Machine), #エックスレイ(X-ray)



X線・CT検査装置(X-ray, CT Inspection Machine)

TGV（ガラス基板）や半導体PKGなど、幅広い半導体分野に
適用可能な X線（CT）検査装置を、お客様のニーズに
合わせて提供

We provide X-ray (CT) inspection systems that can be
applied to a wide range of semiconductor fields, includ-
ing TGV (glass substrates) and semiconductor PKG,
tailored to our customers' specific needs.



AQLASER

#LaserApplicationレーザー応用技術 #LaserProcessingレーザー加工
#GlassCoreSubstrate #TGV #LaserSingulationシンギュレーション

次世代半導体・先端基板プロセスをリードするレーザ ーソリューション企業

- ・多様なプロセスソリューション：ボンディング、TGVドリル加工、シングレーション、レーザーウオータージェット、カッティングなど、全工程に対応
- ・コア技術の内製化：レーザー加工技術、光学系の設計・製作、スキャナー／ステージの統合制御技術を保有
- ・高精度・高信頼性の装置設計力
：大面積基板の高速加工と精密制御技術を確立

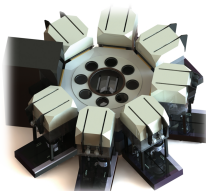


NANOCORE

#Cu Seed (NCP) #HAR TGV #5N #High Adhesion

ナノコア NCP™ Cuシード ソリューション

- ・ガラス基板上のめっき用高密着Cuシード（NCP）成膜（ピール強度 5 N以上）
- ・高アスペクト比TGVガラス基板への均一成膜が可能
- ・Cuシード（NCP）成膜サービスおよびNCP装置販売



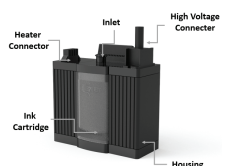
ENJET

#Inkjet Head #EHDInkjet #R&D #HighViscosity
#InkjetPrinting #PiezoInkjet #LabScale #DropOnDemand

High Viscosity ink jetting?

We have Engineered an Advanced Inkjet Multi-Nozzle Printing System.

- SI Nozzle Plate (16 nozzles)
- Viscosity Range : 1~200 cP (@20 °C)
- Resolution : 100NPI
- Jetting Frequency : Up to 30kHz
- Heating Temperature : Up to 50°C
- Drop Volume : 10 pL
→ Customized 2, 5, 30, 50, 80pL



2026 NEPCON JAPAN

SBJ Forum Joint Pavilion



UniJet

#Inkjet Printer #OLED TFE #Perovskite
#semiconductor Packaging

電子印刷用インクジェット技術およびプリンター

- OLED、半導体パッケージ、ペロブスカイト太陽電池、モバイル機器など
- 2,500件以上のプロセス開発実績プロセスに最適化されたR&D・量産用インクジェットプリンターを提供



(株)パウエルコーポレーション

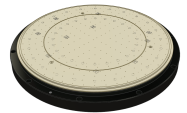


Powel Corporation Co., Ltd.

#Semiconductor #Secondary Battery #Power Semiconductor

PDS ESC

PDS ESCは、プラズマ密度を測定するバー型センサーが内蔵された静電チャック。プラズマ処理中にプラズマ密度を正確に測定する世界初の発明品



ESC Controller

静電チャックは、基板を下部電極に固定するために静電気力とコア部を使用



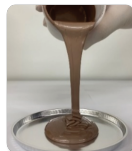
エプシロン

epsilon

#銀メッキ銅 #ダイアタッチ銅ペースト #EMIシールド #パワー半導
#Silver Coated Copper #Die Attach Copper Paste
#EMI Shielding #Power Semiconductors

銀メッキ銅などの導電性フィラー 高電力半導体用ダイアタッチ銅ペースト

Conductive fillers such as silver-plated copper and die-attach copper paste for high-power semiconductors.



- 経済的で、優れた電気伝導性
Economical yet possessing excellent electrical conductivity
- 40MPa以上の優れたせん断強度を有するダイアタッチ銅ペースト
Die attach copper paste with excellent shear strength over 40 MPa



エイチエル・オプティクス



HL OPTICS Co., Ltd

#SiC #GaN #Ag #Cu #Hybrid Sintering #Soldering

ハイブリッド・シンタリング・システム Hybrid Sintering System

The best solution for power semiconductor module manufacturing.
パワー半導体モジュールの製造に最適なソリューション

Ag, Cu, Solder all available.
Ag, Cu, Solderはすべて利用可能

Atmospheric/vacuum pressure is available.
大気圧用・真空用利用可能

Forming gases (HCOOH, N₂, H₂, etc.) are available.
フォーミングガス (HCOOH, N₂, H₂など) が利用可能



(株)三煥ティエフ (SAMHWANTF Co., Ltd.)

#LCP繊維 #織物 #LCP_YARN #COLORED_LCP

三煥ティエフ LCP の特徴 (Features of Samhwan TF LCP)

三煥ティエフの LCP繊維は低環境負荷・高物性・低コスト・高い生産性を持っている素材として幅広く多様な分野に活用ができ。特に、自動車システム、ハイパースケールデータセンターケーブル、先進PCB用途に対応

As an eco-friendly, highly efficient, low-cost, and highly productive material, Samhwantf's LCP can be used in a wide range of fields. Specially designed for high-reliability automotive applications, hyperscale data-center cables, and advanced PCBs.



SUNGMUN ELECTRONICS

#Rotary DIP Switch #高信頼性 #小型設計 #メンテナンス性
#IoT対応 #ネットワーク化機器 #スマート化・自動化 #明確な設定

Rotary DIP Switch : スマート産業の“明確な設定”

SUNGMUN のRotary Dip Switchはスマート化・自動化・ネットワーク化が加速される産業環境において、高い信頼性と小型設計・保守の利便性などを同時に実現する、IoT時代の必須設定スイッチ

主に複数のオプションが必要な製品に適合
(例：アドレス設定、オプション設定など)



2026 NEPCON JAPAN

SBJ Forum Joint Pavilion

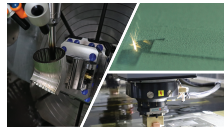


M3 PARTNERS / PARTNERS LAB

#Injection Molding #Machining #3D Printing

Everything about manufacturing

迅速な試作から拡張可能な生産に至るまで、当社は世界中のイノベーターが他社の追随を許さないスピード、柔軟性、技術専門性を武器に、コンセプトを市場に投入できるよう支援



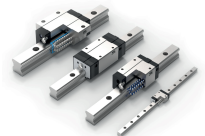
WON ST

#LinearMotionGuide #LMGuide #LinearGuide
#FactoryAutomation #IndustrialAutomation #SmartFactory

LM Guide, Ball Screw, Linear Bushing / Shaft, ball spline, cross roller bearing

Beyond Motion, Beyond Limits

LM guideのような直線ベアリングの
韓国製造企業

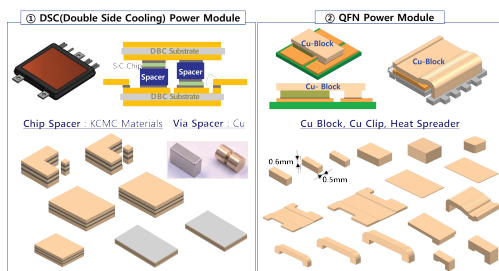


KOSTECSYS

#BlockBonding #UltraLowInductance
#SiCSpacer #HighThermalConductivity&LowCTE

Block Bonding Cu Block

Rising Demand for SiC and GaN Devices!
Limitations of Conventional Wire Bonding!
Block Bonding Packing is the innovative solution!



THOMAS CABLE

#半導体 #ディスプレイ #パーティクル #ムービングシステム

WOWFLEX

本ケーブル可動システムは、クリーンルーム環境で従来のケーブルベアを代替し、パーティクルの発生を最小限に抑える設計を採用し、半導体・ディスプレイなどの高洗浄プロセスに最適化され、最大4,800mmの移動距離とIPAクラス1等級を実現



[株式会社] FASTECH JAPAN

#CC-Link IE TSN #モーションコントローラ
#モーター・ドライブ # Closed Loop Stepping System



三菱電機の CC-Link IE TSN 対応 PLC に接続可能な製品提供

• MX Controller、MELSEC iQ-R、FX5と互換性が検証された6ブランドの20種類の製品

1. [Ezi-SERVO] クローズドループステッピングシステム
2. [Ezi-STEP] マイクロステッピングシステム
3. [Ezi-POS] 低電圧サーボ制御システム
4. [Ezi-SPEED] BLDC モーター速度制御システム
5. [Ezi-ROBO] 標準化された、小型精密アクチュエータ
6. [Ezi-IO] イン/アウトDI0、アナログ入出力I0モジュール



HANSHIN

#フレックシブルフィーダ#多品種少量部品ハンドリング
#ロボット&ビジョン連動#MDM技術適用#アクチュエータ特許

多品種少量部品ハンドリングに最適化された フレックシブルフィーダ

MDM技術を適用したインテリジェントな
部品ハンドリングの実現

- 1つのフィーダで様々な種類の部品を効率的に処理可能
- 一般フィーダーでは対応が困難な部品や不可能な部品までも処理可能

